

1-104351-2 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU Headers

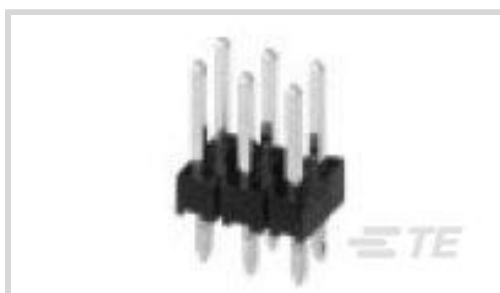
TE 内部编号 1-104351-2

AMPMODU Headers, PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 24 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Breakaway, Gold, Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 24

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|----------|
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统 | 板对板 |
| 接头类型 | 分离 |
| Sealable | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

| | |
|---------------------|----|
| 行数 | 2 |
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| PCB 安装方向 | 垂直 |
| Number of Positions | 24 |
| 板对板配置 | 平行 |

电气特征

| | |
|-------------------|--------|
| Operating Voltage | 30 VAC |
|-------------------|--------|

主体特性

| | |
|-------|----|
| 连接器外形 | 标准 |
|-------|----|

接触件特性

| | |
|--------|-----------------|
| 接合方柱尺寸 | .64 mm[.025 in] |
| | 100 – 200 μin |

| | |
|----------------|---|
| 端子形状和构造 | 正方形 |
| 端子底板材料 | 镍 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡铅 |
| 端子基材 | 磷青铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .381 μm [15 μin] |
| 端子类型 | 插针 |
| 端子额定电流（最大值） | 3 A |

端接特性

| | |
|-------------|-----------------|
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .64 mm[.025 in] |
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.05 mm[.12 in] |
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |

机械附件

| | |
|------------|------|
| PCB 安装固定类型 | 固定焊尾 |
| 接合对准 | 不带 |
| PCB 安装固定 | 带有 |
| PCB 安装对准 | 不带 |
| 连接器安装类型 | 板安装 |

壳体特性

| | |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |
| 壳体颜色 | 黑色 |
| 外壳材料 | 热塑性 |

尺寸

| | |
|--------------------|------------------|
| Row-to-Row Spacing | 2.54 mm[.1 in] |
| PCB 厚度（建议） | 1.57 mm[.062 in] |

使用环境

| | |
|---------|--|
| 壳体温度额定值 | 标准 |
| 工作温度范围 | -65 – 105 $^{\circ}\text{C}$ [-85 – 221 $^{\circ}\text{F}$] |

操作/应用

| | |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

| | |
|--------|-----------------------|
| 已批准的标准 | CSA LR7189, UL E28476 |
|--------|-----------------------|



UL 阻燃性等级

UL 94V-0

包装特性

封装数量

120

封装方法

Carton

其他

注释

请参阅客户图纸以确定电路板固定尾的数量和位置。如需其他尾部长度，请咨询 AMP Incorporated。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)

超过限值的SVHC:

Pb (13% in Component Part)

物品安全使用说明:

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

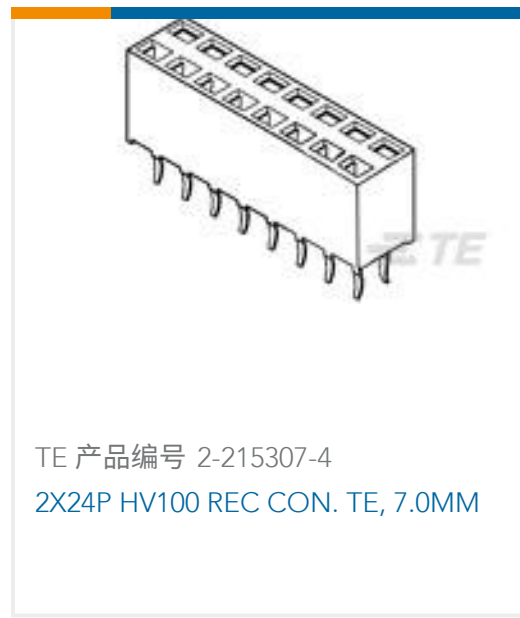
焊接工艺能力

波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers



客户还购买了





文档

产品图纸

[24 MODII HDR DRST B/A W/HD](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-104351-2_U.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-104351-2_U.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-104351-2_U.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本